



ЭТИКЕТКА

Микросхема интегральная пленочная типа
301НР1. Основное назначение: декоди-
рующая резистивная матрица типа R-2R

Схема расположения выводов

Обозначение

первого вывода

1

Отсчет выводов производится против часовой
стрелки от обозначения первого вывода.

Схема электрическая принципиальная

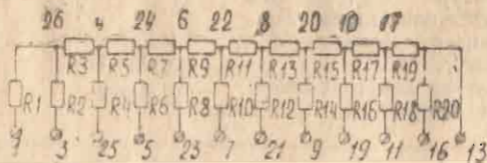


Таблица назначения выводов

Контакт	Цена (сопротивление), кОм	Контакт	Цена [сопротивление] кОм
1	2	1	2
1-26	R1-10	22-8	B11-5
3-26	R2-10	21-8	B12-10
26-4	R3-5	8-20	B13-5
25-4	R4-10	9-20	B14-10
4-24	R5-5	20-10	B15-5
5-24	R6-10	19-10	B16-10
24-6	R7-5	10-17	B17-5
23-6	R8-10	11-17	B18-10
6-22	R9-5	17-13	B19-5
7-22	R10-10	16-13	B20-10

Основные электрические параметры при поставке

Наименование параметра	Норма	
	не более	не менее
1	2	3
Сопротивление резисторов, кОм		
2R	11	9
R	5,5	4,5
Температура -60, +25, +85°C		
Относительная погрешность		
Коэффициент деления—бк, %		
Температура +25°C	± 0,0135	—
Температура минус 60, +85°C	± 0,032	—
Входное напряжение не более		
12,6 В		

Наименование параметра	Норма	
	не более	не менее
1	2	3
Сопрот. изоляции—В из, МОм Температура +25°C	—	100
Испытательное напряжение. 100В Время установления переходных процессов—уст, МКС	0,5	—
Температура — 60, +25, +85°C		
Температурный коэффициент сопротивления—ТКС, 1°С	-4	—
Температура — 60, +25, +85°C	+2,5.10	—

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра	Тип (типономинал) микросх.	Норма		Примечание
		не менее	не более	
1	2	3	4	5
Рассеиваемая мощность—P _{рас} , мВт	30IHP1	—	50	—

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

ЗОЛОТО	1,227	мг.
СЕРЕБРО	90,27	мг.

в одной микросхеме

в том числе: серебро 0,0001549 г-мм
на 28 выводах длиной 8,08 мм

Указания по эксплуатации

1. Выводы микросхем формовке не подлежат. В технически обоснованных случаях допускается удалить нерабочие выводы микросхем и лишние рабочих выводов после пайки любым способом, исключающим нарушение запрессовки выводов в основании корпуса и не приводящим к ухудшению электрических параметров микросхем.

2. Допускается 3-х кратный монтаж и демонтаж микросхем, при этом электрические параметры должны соответствовать нормам в ТУ.

3. Интервал между пайками соседних выводов не менее 10 с, жало паяльника должно быть заземлено.

4. Для повышения влагоустойчивости микросхемы должны быть покрыты после монтажа на платы тремя слоями лака Э-4100 или УР-231; температура сушки лака не должна превышать $80^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Микросхема типа 301НР1 соответствует техническим условиям ОЖО. 345. 001 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК
ОТК
2-21

90 10

Штамп

Штамп представителя заказчика

